

证券简称：胜宏科技

证券代码：300476

上市地点：深圳证券交易所

胜宏科技（惠州）股份有限公司



2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告

二〇二一年四月

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“公司”）拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过人民币 200,000 万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	298,946.52	150,000.00
2	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		348,946.52	200,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析

（一）高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目

1、建设项目的的基本情况

（1）项目基本情况

公司高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目计划总投资 298,946.52 万元，其中拟以募集资金投入 150,000.00 万元，用于本项目建设投资，由子公司南通胜宏科技有限公司实施，实施地点为南通市海门经济技术开发区滨江工业城苏州路北、扬子江路东。本项目的建设期为 24 个月。

（2）投资概算

本项目计划总投资 298,946.52 万元，其中建设投资 285,284.02 万元，铺底流动资金 13,662.49 万元。

（3）经济效益估算

本项目建设期 2 年。项目达产后，预计年均实现销售收入 436,500.00 万元，年均实现净利润 55,830.19 万元，项目静态投资回收期为 6.27 年（所得税后，含建设期），税后投资内部收益率为 19.49%。

（4）项目审批及备案情况

截至本预案公告日，本项目已取得江苏省南通市海门区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，正在履行项目环评程序。

2、项目建设的必要性

（1）优化公司产品结构，顺应行业未来发展趋势的需要

近年来，智能手机、平板电脑和可穿戴设备等电子产品向小型化、轻薄化和多功能化方向发展，印制线路板导线宽度、间距，微孔盘的直径和孔中心距离，以及导体层和绝缘层的厚度都在不断下降。随着电子产品的更新换代速度加快，HDI 与 IC 封装基板凭借其独特的优势，更加符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势，在电子信息产业领域扮演了愈加重要的基石角色，逐渐成为笔记本电脑、智能手机、平板电脑、数码相机等消费电子产品不可或缺的元器件。

近年来，为顺应市场发展趋势，公司产品不断向高附加值方向发展，多层板销售收入逐年增加。但由于场地和设备的产能限制，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求，为保持良好的市场竞争力，公司产能扩张和产品结构调整迫在眉睫。本项目产品包括高端多层板、高阶 HDI 和 IC 封装基板，本募投项目的实施可以进一步优化现有的产品结构，顺应行业未来发展趋势。

（2）进一步提高公司的营收和利润水平的需要

作为一家 PCB 产品开发、生产和销售的高新技术企业，公司十分重视科研力量与市场需求的相结合。公司以市场为导向，保持大力度科研投入，不断促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化，不断提升企业竞争力，以先进的技术工艺水平，搭配全方位优质产品与服务，为国内外客户创造更加优质的产品。

通过本项目的实施，公司可以有效扩大高端多层板、高阶 HDI 产品的生产规模，并实现 IC 封装基板的量产，进一步优化现有的产品结构的同时，开拓产品附加值更高的高阶 HDI 和 IC 封装基板市场，大大提高公司的营收和利润水平。

(3) 巩固行业地位，提高高端市场占有率的需要

公司是一家专业从事 PCB（高精密度线路板、HDI）研发、设计、制造和销售的高新技术企业，产品广泛用于计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等领域，产品获得亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、中兴、富士康等知名客户或终端品牌的认证，2019 年位列全球 PCB 供应商第 32 名，公司已经发展成为我国印制线路板产品制造领域的领先的企业。

但公司目前的生产规模相对国外的领先生产商还有较大的距离，通过本项目的实施，有利于公司提升和合理配置产能，加大生产技术含量更高、盈利能力更强的高端多层板、HDI 板和 IC 封装基板的比重，增强公司的核心竞争力，提高高端市场的占有率，巩固公司领先地位，为公司的未来发展奠定良好的基础。

3、项目建设的可行性

(1) 不断扩大的市场规模为项目开展提供重要保障

PCB 的下游应用领域较为广泛，近年来下游行业更趋多元化，产品应用覆盖通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等各个领域。PCB 行业与下游行业的发展相互关联、相互促进。一方面，PCB 下游行业良好的发展势头为 PCB 产业的成长奠定了基础，下游行业对 PCB 产品的高系统集成、高性能化不断提出更严格的要求，推动了 PCB 产品朝着“轻、薄、短、小”的方向演进升级；另一方面，PCB 行业的技术革新为下游行业产品的推陈出新提供了可能性，从而进一步满足终端市场需求。

在产品类型上，由于 PCB 行业整体上向高密度、轻薄化方向发展，产品不断缩小体积，轻量轻薄，性能升级，以适应下游不同应用领域的需求，更精密的 HDI 板和封装基板的投入将不断加大。

Prismark 对 2020 年-2025 年全球不同种类 PCB 产值及年增长率预测如下表所示：

单位：亿美元

种类	2019 年 产值	2020 年 产值	2020 年/ 2019 年增长率	2025 年 产值	2025 年 F/ 2020 年增长率
单/双面板	80.9	78.3	-3.20%	93.4	3.60%
多层板	238.8	247.6	3.70%	316.8	5.10%

种类	2019 年 产值	2020 年 产值	2020 年/ 2019 年增长率	2025 年 产值	2025 年 F/ 2020 年增长率
HDI 板	90.1	99.5	10.50%	137.4	6.70%
挠性板	122	124.8	2.40%	153.6	4.20%
IC 封装基板	81.4	101.9	25.20%	161.9	9.70%
合计	613.1	652.2	6.40%	863.3	5.80%

根据 Prismark 统计，2020 年全球单/双面板总产值同比下降 3.2%的同时，其他 PCB 产品细分领域均呈现不同幅度的增长，其中多层板、挠性板、HDI 板、封装基板在 2020 年总产值分别同比增长 3.7%、2.4%、10.5%、25.2%，IC 封装基板、HDI 板领域业绩增长强劲，市场需求旺盛，关键驱动因素来自计算机行业包括台式、笔记本、平板电脑等产品市场需求旺盛，以及服务器、网络和 AI 设备等计算机基础设施产品发展。据 Prismark 预计，IC 封装基板、HDI 板和多层板的增速将明显超过其它 PCB 产品，预计在 2020-2025 年分别实现 9.7%、6.7%和 5.1%的复合增长率，高端多层板、HDI 办和 IC 封装基板不断扩大的市场规模为本项目开展提供重要保障。

（2）公司拥有优质客户资源群体

公司凭借先进的生产技术和优异的产品性能，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得了较高的市场地位，公司产品已远销韩国、印度、俄罗斯、墨西哥、埃及和东南亚等多个国家和地区，并且在消费电子、通讯、汽车等行业领域积累了一大批稳定合作的优质客户。公司凭借“技术新、品质优、交期快、服务好”在业内树立了良好的声誉，已与富士康、共进电子、戴尔、纬创、达创科技、TCL、德赛西威、嘉威科技、仁宝、赛尔康、歌尔声学、LG 等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛应用于苹果、三星、CISCO、惠普、联想、日立、LG、夏普、台达、SKY 等国内外众多知名企业产品。

广泛的客户数量及高品质的客户为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，可以保障本项目的顺利实施。

（3）公司拥有高素质员工团队和研发人员储备

公司多年来专注于印制线路板产品的研发，已经形成了一支专业化的研发团队，积累了大量的技术与经验。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有员工 8,959 人，其中技术人员 932 人。通过不断的外部招聘和内部培养，公司形成了一支拥有专业水平和实践能力的高素质员工团队，能够为本项目的顺利实施

提供保障。

（二）补充流动资金和偿还银行贷款项目

1、项目基本情况

公司计划将本次募集资金中的 50,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款，由母公司胜宏科技（惠州）股份有限公司实施，以优化公司财务结构，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

2、项目的必要性

（1）补充营运资金满足公司业务快速发展的需求

基于行业当前发展趋势和竞争格局的变化，结合公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓、研发投入等活动中需要大量的营运资金。报告期内，公司营运资金主要通过向银行贷款的方式解决，资金成本压力较大，且借款额度受银行相关政策影响较大，如果没有大量稳定持续的流动资金进行补充，将影响公司的后续发展。受公司业务类型、结算方式等因素的影响，公司应收账款、应收票据、存货的规模较大，对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。

通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，提高公司抗风险能力，增强公司总体竞争力。

（2）降低财务杠杆，增强抗风险能力

为支持发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦不断增加。为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行贷款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，充分利用了财务杠杆，为公司的发展提供了有力支持，同时也导致公司资产负债率逐步增高。公司资产负债率、流动比率、速动比率情况如下：

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产负债率	61.49%	52.44%	44.87%
流动比率	0.79	0.81	1.08
速动比率	0.62	0.64	0.91

公司可通过本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，优化财务结

构，降低负债规模，控制经营风险，增强抗风险能力。

3、项目的可行性

(1) 本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

(2) 公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目的实施有利于促进公司现有主营业务的持续健康发展，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，对于扩大公司业务规模、提升公司服务水平、增强公司综合竞争力都将产生积极影响，符合公司长远发展战略。本次募集资金投资项目实施后将进一步提升公司盈利能力，巩固并提高公司在行业内的地位，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

1、增大公司总资产与净资产规模

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增大，有助于增强公司资金实力，为公司后续发展提供有力保障。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

2、提升财务抗风险能力，增强资金实力

本次发行完成后，有利于增强公司的资本实力，财务结构进一步优化，偿债能力显著提高，进一步降低财务风险，保持稳健的财务结构。

四、 募集资金使用可行性分析结论

本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力及抗风险能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金是必要且可行的。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2021年4月29日